



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **8**Zeilenanzahl: **2**

Eigenschaften

Produktmerkmale

| | |
|---|--|
| PCB-Steckverbindermontagetyp | Stiftleiste für die Leiterplattenmontage |
| Steckverbindersystem | Leiterplatte-an-Leiterplatte |
| Stecksockeltyp | Teilweise ummantelt |
| Abdichtbar | Nein |
| Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an | Leiterplatte |

Konfigurationsmerkmale

| | |
|---|---------------|
| Ladungszustand des Steckverbinderkontakts | Voll bestückt |
| Montageausrichtung für Leiterplatte | Vertikal |
| Anzahl von Positionen | 8 |
| Zeilenanzahl | 2 |

Elektrische Kennwerte

| | |
|----------------------------|-------|
| Spannungsfestigkeit (max.) | 750 V |
|----------------------------|-------|

Sonstige Eigenschaften

| | |
|----------------------------|----------|
| Profil des Steckverbinders | Standard |
|----------------------------|----------|

| | |
|----------------------|---------|
| Primäre Produktfarbe | Schwarz |
|----------------------|---------|

Kontaktmerkmale

| | |
|---|--------|
| Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte | 2.5 µm |
|---|--------|

| | |
|-------------|------|
| Kontaktform | Rund |
|-------------|------|

| | |
|---|------|
| Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers | Hell |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte | Zinn |
|---|------|

| | |
|-----------------|---------|
| Kontaktmaterial | Messing |
|-----------------|---------|

| | |
|--|------|
| Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts | Gold |
|--|------|

| | |
|---|-----------------|
| Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts | .381 µm[15 µin] |
|---|-----------------|

| | |
|------------|-------|
| Kontakttyp | Stift |
|------------|-------|

Klemmenmerkmale

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Anschlussstift- und Restlänge | 3.5 mm[.138 in] |
|-------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Verbindungsmethode für Leiterplatte | Durchsteckmontage - Löten |
|-------------------------------------|---------------------------|

Montage und Anschlusstechnik

| | |
|-----------------------|-----|
| Gegensteckarretierung | Mit |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------------------|------|
| Panelmontagevorrichtung | Ohne |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------|-----|
| Gegensteckführung | Mit |
|-------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Typ der Gegensteckführung | Polarisierung |
|---------------------------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|------|
| Arretierung für Leiterplattenmontage | Ohne |
|--------------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| Montageausrichtung der Leiterplatte | Ohne |
|-------------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Art der Steckverbindermontage | Leiterplattenmontage |
|-------------------------------|----------------------|

Gehäusemerkmale

| | |
|--------|----------------|
| Raster | 2.54 mm[.1 in] |
|--------|----------------|

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Gehäusematerial | Thermoplast, Thermoplast |
|-----------------|--------------------------|

Abmessungen

| | |
|---------------|----------------|
| Reihenabstand | 2.54 mm[.1 in] |
|---------------|----------------|

Verwendungsbedingungen

| | |
|-----------------------|----------|
| Gehäusenenntemperatur | Standard |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Betriebstemperaturbereich | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |
|---------------------------|----------------------------|

Betrieb/Anwendung

| | |
|----------------------|-------------------|
| Stromkreis Anwendung | Strom und Signale |
|----------------------|-------------------|

Verpackungsmerkmale

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungsmenge | 1000 |
| Verpackungs-Typ | Kasten |

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

| | |
|--|---|
| EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU | Konform |
| EU ELV Richtlinie 2000/53/EG | Konform |
| China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 | Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte |
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC |
| Halogengehalt | Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm. |
| Lötfähigkeit | Wellenlötfähig bis 265 °C |

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | AMPMODU Headers



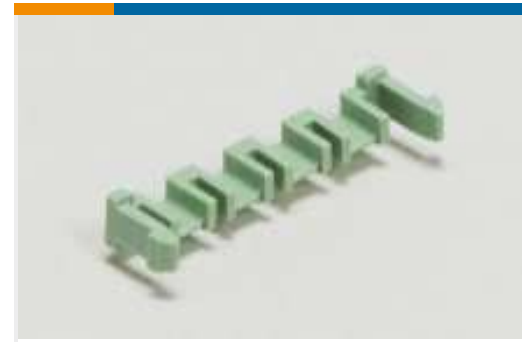
Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckerkontakte (65)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(1)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (4875)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

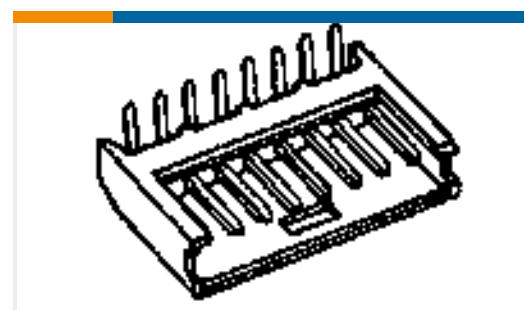
Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:7-1625963-7
HSA5 2R0 5%



TE Teilnr.:280372-2
6P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38 AU



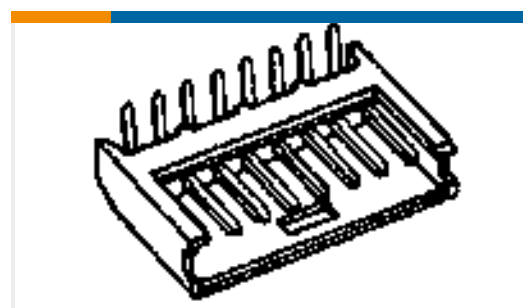
TE Teilnr.:280380-2
8P MODU II SHRD HDR,RT ANG, 0.38 AU



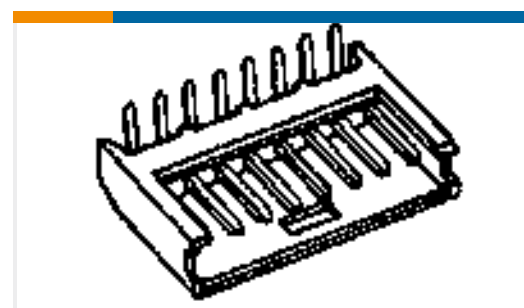
TE Teilnr.:280373-2
8P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38 AU



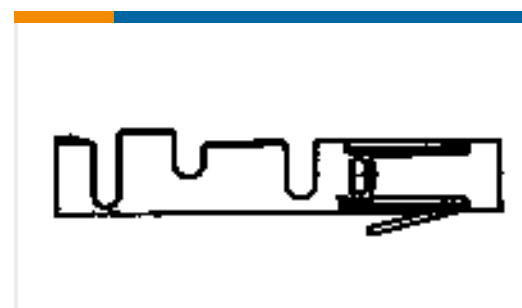
TE Teilnr.:280390-2
2X8P MODU II SHRD HDR,RT ANG, 0.38AU



TE Teilnr.:280377-2
2P MODU II SHRD HDR,RT ANG, 0.38 AU



TE Teilnr.:280378-2
4P MODU II SHRD HDR, RT ANG, 0.38 AU



TE Teilnr.:280530-4
MOD2 BUCHSE



TE Teilnr.:175778-4
CT. CRIMP REC HSG 4P

Dokumente

Produktzeichnungen

[2X4P AMPMODU II SHRD HDR,ST,0.38AU](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_280384-2_T_c-280384-2-t.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_280384-2_T_c-280384-2-t.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_280384-2_T_c-280384-2-t.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[1773393_ AMPMODU EUROPEAN STANDARD PRODUCTS](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_280384-2_06222016859_dmtec](#)

Englisch

[MD_280384-2_06222016859_dmtec](#)

Englisch